【附件二】

教育部基礎深耕計畫（半導體製程設備技術）

科技部MOCVD關鍵零組件技術開發暨人才培育中心

104年度半導體光電製程設備零組件與系統設計專題競賽

<競賽題目：□□□□□>

構 想 書

組別：□大專組 □研究組

學校/系所：

 指導老師：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 參賽隊員：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（隊長）

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**目 次**

(請依此格式撰寫，內文建議以不超過五頁為原則，12號字單行間距)

**1.摘要**

(含作品簡介、創新性與功能性等概要敘述)

**2. 設計原理**

(作品之設計原理、理論依據等)

**3. 作品說明**

(含軟硬體架構、運作方法、預期效用等圖文說明)

**4. 作品優勢**

(本作品之創新性與應用性等，凡可突顯作品優點者，皆屬此類)

**5. 結論**

**6.參考文獻**